

## 医用祛疤贴硅凝胶原材料 透气高粘性有机硅凝胶

产品名称	医用祛疤贴硅凝胶原材料 透气高粘性有机硅凝胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	68.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 用途:医用胶带 祛疤贴 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

### 产品详情

#### 医用祛疤贴硅凝胶原材料 透气高粘性有机硅凝胶

医用祛疤贴硅凝胶原材料的应用：

作用于痤疮烧伤烫伤疤痕、青春痘疤痕、外科手术、增生性疤痕、激光美容术后疤痕、微整形手术后疤痕、剖腹产术后疤痕等；食品级硅凝胶疤痕贴具有透气、快速干燥、柔软、防水、保护、等作用，通过对皮肤角质层的水化作用，改变疤痕组织的结构，使疤痕软化、缩小、变平和褪色，广泛应用于医疗器械产品行业。

产品的性能:

本产品为液态有机硅成型材料，可达到-40度柔软性，且纯度较高，弹性较强，原材料调制完成后与硅橡胶原料不同，不会出现凝固状态，在硫化过程中无任何反应变化！硫化前具备很好的流动性，便于操作生产，与EVA、PVC、布料有很好的附着力，与皮肤接触时可重复使用，表面产

生污渍时，用洗洁精涂抹，再用清水冲洗即可。

祛疤贴医用硅凝胶固化前后技术参数：

粘度 ( cps ) : 600-1200

可操作时间 ( min ) : 40-60

比例 : 1 : 1

固化时间 ( hr , 室温25 ) : 3-5

混合后黏度 ( cps ) : 680 ~ 1400

固化时间 ( min , 80 ) : 20

硬度(shore A) : 0度以下

体积电阻率 (  $\Omega \cdot \text{cm}$  ) :  $1.0 \times 10^{16}$  ( 16次方 )

线膨胀系数 [m/ ( m · K ) ] :  $2.2 \times 10^{-4}$  ( 4次方 )

导热系数 [W ( m · K ) ] : 0.2

介电强度 ( kV/mm ) : 25

阻燃性能 : 94-V1

介电常数 ( 1.2MHz ) : 3.0 ~ 3.3

医用硅凝胶操作方法：

1、A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀（遵守A组分：B组分 = 1：1的重量比）注意，\*\*\*好顺着器壁的一边慢慢注入，以减少气泡的产生。

2、将灌封好的元件静置，让其自行排泡，气泡基本消失后可加温快速固化（80℃条件下，约需30分钟完全固化），亦可直接在室温条件下，完全固化大约需要10小时。

3、应在固化前后技术参数表中给出的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用厚度较厚，固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80~100℃下固化20分钟，室温条件下一般需8小时左右固化。

。